

1-84927-3 ✓ 有效

Free Height

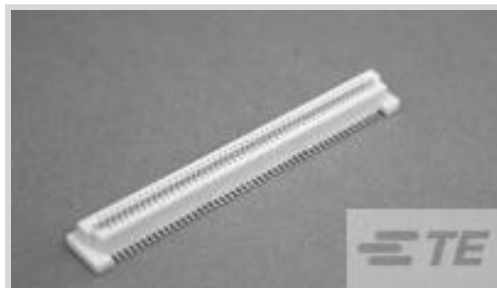
TE 内部编号 1-84927-3

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 80 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Gold, Surface Mount, Signal, Natural, Free Height

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > 自由高度插座连接器：板对板，垂直，80，0.8mm



连接器系统: 板对板

位数: 80

中心线 (间距) : .8 mm [.031 in]

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 表面贴装

[所有 自由高度插座连接器：板对板，垂直，80，0.8mm \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 板对板 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |

结构特性

| | |
|----------|----|
| 板对板配置 | 平行 |
| 可堆叠 | 是 |
| 位数 | 80 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 介质耐压 (最大值) | 500 VAC |
| 绝缘电阻 | 2 MΩ |
| 工作电压 | 100 VAC |

主体特性

| | |
|----------|--------|
| 装配过程特性材料 | 聚酰亚胺薄膜 |
| 主要产品颜色 | 土黄色 |

接触件特性

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | .05 μm [2 μin] |
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .2 μm [8 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 金 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子类型 | 插座 |
| 端子额定电流 (最大值) | .5 A |

端接特性

| | |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

| | |
|------------|---------------|
| 安装校准特征长度 | .5 mm[.02 in] |
| PCB 安装对准类型 | 定位凸耳 |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 带有 |
| PCB 安装固定 | 不带 |

壳体特性

| | |
|----------|----------------|
| 接合入口位置 | 顶部 |
| 外壳材料 | 亮光 |
| 中心线 (间距) | .8 mm[.031 in] |

尺寸

| | |
|-------|--|
| 堆叠高度 | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm[.197 in][.236 in][.276 in][.315 in] |
| 连接器高度 | 5 mm[.197 in] |

使用环境

| | |
|---------|--|
| 壳体温度额定值 | 高 |
| 工作温度范围 | -40 – 125 $^{\circ}\text{C}$ [-40 – 257 $^{\circ}\text{F}$] |

操作/应用

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



| | |
|--------|----------|
| 装配工艺特点 | 拾放盖, 拾放盖 |
|--------|----------|

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|--|-------|
| | .5 in |
|--|-------|

| | |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
|------|------|

| | |
|------|------------|
| 封装方法 | 卷带包装, 卷带包装 |
|------|------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

| | |
|---|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---|-------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
|-----------------------------|---|

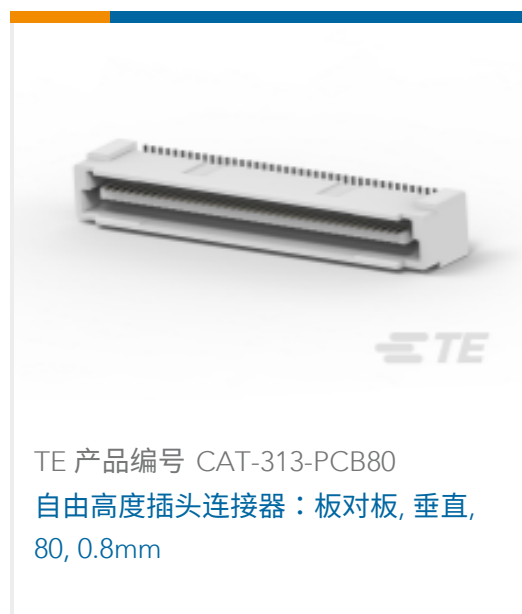
| | |
|------|---|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---|

| | |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Free Height



客户还购买了



文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-84927-3_F.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-84927-3_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-84927-3_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本